

典型应用

★ IC 封装基板

★ coreless

典型特征

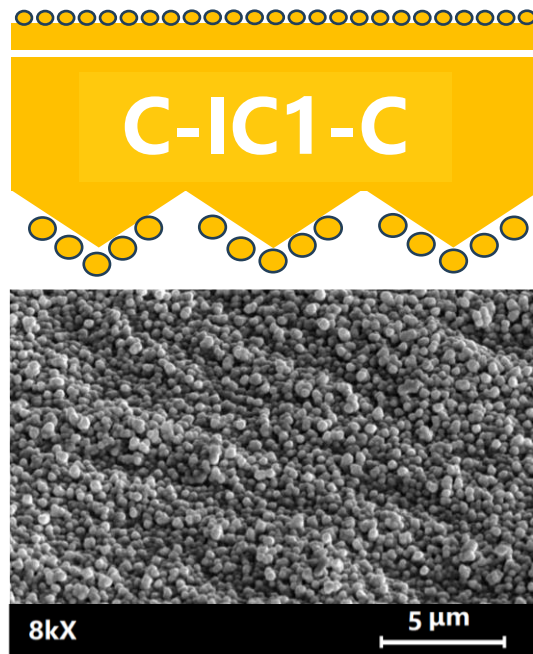
★ 超薄

★ 低粗糙度

★ 载体层粗糙化处理

★ 适配coreless技术

典型技术指标



项目	单位	性能参数	测试方法	
标称厚度	μm	3/18	IPC-4562A	
单位面积质量	g/m ²	33/140	IPC-TM-650 2.2.12	
薄铜粗糙度Rz	处理面	2.0	IPC-TM-650 2.2.17	
	非处理面	1.5		
载体粗糙度Rz	处理面	4.0	IPC-TM-650 2.2.17	
分离力	BT	N/mm	0.02	IPC-TM-650 2.4.8.4
薄铜剥离强度	BT	lb/in	3.0	IPC-TM-650 2.4.8
载体剥离强度	BT	lb/in	3.5	IPC-TM-650 2.4.8

★ 以上数据为典型值，非保证值。

★ 半固化片会影响剥离强度，铜箔使用前请进行半固化片匹配实验或咨询德福科技技术服务人员。上述超薄铜箔剥离强度测试，是加厚到35μm后的测试结果。

网站: www.jjdefu.com

电话(传真) : 0792-8252044

地址: 江西省九江市汽车工业园顺意路15号

